

# 2023-2029年全球与中国芯片封测市场深度调查与 投资前景评估报告

报告大纲

共研网

[www.gonyn.com](http://www.gonyn.com)

## 一、报告简介

官网地址：<https://www.gonyn.com/report/1552446.html>

报告价格：电子版: 15000元 纸介版：15000元 电子和纸介版: 15500元

订购电话: 010-69365838 / 400-700-9228

电子邮箱: kefu@gonyn.com

联系人: 李经理

## 二、报告目录及图表目录

在经济全球化以及互联网快速发展的大趋势下，全球市场需求在不断释放，随着云计算、大数据、人工智能等新兴数字技术广泛运用于行业生产及销售领域，行业有望迎来新的发展契机。

2022年全球芯片封测市场规模大约为 亿元（人民币），预计2029年将达到 亿元，2023-2029期间年复合增长率（CAGR）为%。未来几年，本行业具有很大不确定性，本文的2023-2029年的预测数据是基于过去几年的历史发展、行业观点、以及本文分析师观点，综合给出的预测。

2022年中国占全球市场份额为 %，美国为 %，预计未来六年中国市场复合增长率为 %，并在2029年规模达到 百万美元，同期美国市场CAGR预计大约为 %。未来几年，亚太地区的重要市场地位将更加凸显，除中国外，日本、韩国、印度和东南亚地区，也将扮演重要角色。此外，未来六年，预计德国将继续维持其在欧洲的领先地位，2023-2029年CAGR将大约为 %。

目前全球市场，主要由 和 地区厂商主导，全球芯片封测头部厂商主要包括日月光半导体、Amkor Technology、长电科技、矽品科技和力成科技等，前三大厂商占有全球大约 %的市场份额。

本报告研究“十三五”期间全球及中国市场芯片封测的发展现状，以及“十四五”期间行业发展预测。重点分析全球主要地区芯片封测的市场规模，历史数据2018-2022年，预测数据2023-2029年。

本文同时着重分析芯片封测行业竞争格局，包括全球市场主要企业中国本土市场主要企业竞争格局，重点分析全球主要企业近三年芯片封测的收入和市场份额。

此外针对芯片封测行业产品分类、应用、行业政策、行业发展有利因素、不利因素和进入壁垒也做了详细分析。

全球及国内主要企业包括：

日月光半导体

Amkor Technology

长电科技

矽品科技

力成科技

通富微电

华天科技

京元电子

南茂科技

颀邦科技

上海华岭

利扬芯片

Applied Materials

ASM Pacific Technology

Kulicke & Soffa Industries

TEL

Tokyo Seimitsu

UTAC

Hana Micron

OSE

NEPES

Unisem

Signetics

Carsem

Teradyne

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

测试

封装

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

电信

汽车

航空航天和国防

医疗设备

消费类电子产品

其他

本文包含的主要地区和国家：

北美（美国和加拿大）

欧洲（德国、英国、法国、意大利和其他欧洲国家）

亚太（中国、日本、韩国、中国台湾地区、东南亚、印度等）

拉美（墨西哥和巴西等）

中东及非洲地区

本文正文共9章，各章节主要内容如下：

第1章：报告统计范围、产品细分、下游应用领域，以及行业发展总体概况、有利和不利因素、进入壁垒等；

第2章：全球市场总体规模、中国地区总体规模，包括主要地区芯片封测总体规模及市场份额等；

第3章：行业竞争格局分析，包括全球市场企业芯片封测收入排名及市场份额、中国市场企业芯片封测收入排名和份额等；

第4章：全球市场不同产品类型芯片封测总体规模及份额等；

第5章：全球市场不同应用芯片封测总体规模及份额等；

第6章：行业发展机遇与风险分析；

第7章：行业供应链分析，包括产业链、主要原料供应情况、下游应用情况、行业采购模式、生产模式、销售模式及销售渠道等；

第8章：全球市场芯片封测主要企业基本情况介绍，包括公司简介、芯片封测产品介绍、芯片封测收入及公司最新动态等；

第9章：报告结论。

报告目录：

## 1 芯片封测市场概述

### 1.1 产品定义及统计范围

### 1.2 按照不同产品类型，芯片封测主要可以分为如下几个类别

#### 1.2.1 不同产品类型芯片封测增长趋势2018 VS2022 VS 2029

#### 1.2.2 测试

#### 1.2.3 封装

### 1.3 从不同应用，芯片封测主要包括如下几个方面

#### 1.3.1 不同应用芯片封测增长趋势2018 VS2022 VS 2029

#### 1.3.2 电信

#### 1.3.3 汽车

#### 1.3.4 航空航天和国防

#### 1.3.5 医疗设备

#### 1.3.6 消费类电子产品

#### 1.3.7 其他

### 1.4 行业发展现状分析

#### 1.4.1 十四五期间芯片封测行业发展总体概况

#### 1.4.2 芯片封测行业发展主要特点

#### 1.4.3 进入行业壁垒

#### 1.4.4 发展趋势及建议

## 2 行业发展现状及“十四五”前景预测

### 2.1 全球芯片封测行业规模及预测分析

#### 2.1.1 全球市场芯片封测总体规模（2018-2029）

- 2.1.2 中国市场芯片封测总体规模 (2018-2029)
- 2.1.3 中国市场芯片封测总规模占全球比重 (2018-2029)
- 2.2 全球主要地区芯片封测市场规模分析 (2018VS 2022 VS 2029)
  - 2.2.1 北美 (美国和加拿大)
  - 2.2.2 欧洲 (德国、英国、法国和意大利等国家)
  - 2.2.3 亚太主要国家/地区 (中国、日本、韩国、中国台湾、印度和东南亚)
  - 2.2.4 拉美主要国家 (墨西哥和巴西等)
  - 2.2.5 中东及非洲地区
- 3 行业竞争格局
  - 3.1 全球市场竞争格局分析
    - 3.1.1 全球市场主要企业芯片封测收入分析 (2018-2023)
    - 3.1.2 芯片封测行业集中度分析：2022年全球Top 5厂商市场份额
    - 3.1.3 全球芯片封测第一梯队、第二梯队和第三梯队企业及市场份额
    - 3.1.4 全球主要企业总部、芯片封测市场分布及商业化日期
    - 3.1.5 全球主要企业芯片封测产品类型及应用
    - 3.1.6 全球行业并购及投资情况分析
  - 3.2 中国市场竞争格局
    - 3.2.1 中国本土主要企业芯片封测收入分析 (2018-2023)
    - 3.2.2 中国市场芯片封测销售情况分析
  - 3.3 芯片封测中国企业SWOT分析
- 4 不同产品类型芯片封测分析
  - 4.1 全球市场不同产品类型芯片封测总体规模
    - 4.1.1 全球市场不同产品类型芯片封测总体规模 (2018-2023)
    - 4.1.2 全球市场不同产品类型芯片封测总体规模预测 (2024-2029)
  - 4.2 中国市场不同产品类型芯片封测总体规模
    - 4.2.1 中国市场不同产品类型芯片封测总体规模 (2018-2023)
    - 4.2.2 中国市场不同产品类型芯片封测总体规模预测 (2024-2029)
- 5 不同应用芯片封测分析
  - 5.1 全球市场不同应用芯片封测总体规模
    - 5.1.1 全球市场不同应用芯片封测总体规模 (2018-2023)
    - 5.1.2 全球市场不同应用芯片封测总体规模预测 (2024-2029)
  - 5.2 中国市场不同应用芯片封测总体规模
    - 5.2.1 中国市场不同应用芯片封测总体规模 (2018-2023)
    - 5.2.2 中国市场不同应用芯片封测总体规模预测 (2024-2029)
- 6 行业发展机遇和风险分析

## 6.1 芯片封测行业发展机遇及主要驱动因素

## 6.2 芯片封测行业发展面临的风险

## 6.3 芯片封测行业政策分析

## 7 行业供应链分析

### 7.1 芯片封测行业产业链简介

#### 7.1.1 芯片封测产业链

#### 7.1.2 芯片封测行业供应链分析

#### 7.1.3 芯片封测主要原材料及其供应商

#### 7.1.4 芯片封测行业主要下游客户

### 7.2 芯片封测行业采购模式

### 7.3 芯片封测行业开发/生产模式

### 7.4 芯片封测行业销售模式

## 8 全球市场主要芯片封测企业简介

### 8.1 日月光半导体

#### 8.1.1 日月光半导体基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

#### 8.1.2 日月光半导体公司简介及主要业务

#### 8.1.3 日月光半导体 芯片封测产品规格、参数及市场应用

#### 8.1.4 日月光半导体 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

#### 8.1.5 日月光半导体企业最新动态

### 8.2 Amkor Technology

#### 8.2.1 Amkor Technology基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

#### 8.2.2 Amkor Technology公司简介及主要业务

#### 8.2.3 Amkor Technology 芯片封测产品规格、参数及市场应用

#### 8.2.4 Amkor Technology 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

#### 8.2.5 Amkor Technology企业最新动态

### 8.3 长电科技

#### 8.3.1 长电科技基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

#### 8.3.2 长电科技公司简介及主要业务

#### 8.3.3 长电科技 芯片封测产品规格、参数及市场应用

#### 8.3.4 长电科技 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

#### 8.3.5 长电科技企业最新动态

### 8.4 矽品科技

#### 8.4.1 矽品科技基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

#### 8.4.2 矽品科技公司简介及主要业务

#### 8.4.3 矽品科技 芯片封测产品规格、参数及市场应用

#### 8.4.4 矽品科技 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

#### 8.4.5 矽品科技企业最新动态

### 8.5 力成科技

#### 8.5.1 力成科技基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

#### 8.5.2 力成科技公司简介及主要业务

#### 8.5.3 力成科技 芯片封测产品规格、参数及市场应用

#### 8.5.4 力成科技 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

#### 8.5.5 力成科技企业最新动态

### 8.6 通富微电

#### 8.6.1 通富微电基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

#### 8.6.2 通富微电公司简介及主要业务

#### 8.6.3 通富微电 芯片封测产品规格、参数及市场应用

#### 8.6.4 通富微电 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

#### 8.6.5 通富微电企业最新动态

### 8.7 华天科技

#### 8.7.1 华天科技基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

#### 8.7.2 华天科技公司简介及主要业务

#### 8.7.3 华天科技 芯片封测产品规格、参数及市场应用

#### 8.7.4 华天科技 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

#### 8.7.5 华天科技企业最新动态

### 8.8 京元电子

#### 8.8.1 京元电子基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

#### 8.8.2 京元电子公司简介及主要业务

#### 8.8.3 京元电子 芯片封测产品规格、参数及市场应用

#### 8.8.4 京元电子 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

#### 8.8.5 京元电子企业最新动态

### 8.9 南茂科技

#### 8.9.1 南茂科技基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

#### 8.9.2 南茂科技公司简介及主要业务

#### 8.9.3 南茂科技 芯片封测产品规格、参数及市场应用

#### 8.9.4 南茂科技 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

#### 8.9.5 南茂科技企业最新动态

### 8.10 颀邦科技

#### 8.10.1 颀邦科技基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

#### 8.10.2 颀邦科技公司简介及主要业务



- 8.10.3 颀邦科技 芯片封测产品规格、参数及市场应用
- 8.10.4 颀邦科技 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）
- 8.10.5 颀邦科技企业最新动态
- 8.11 上海华岭
  - 8.11.1 上海华岭基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位
  - 8.11.2 上海华岭公司简介及主要业务
  - 8.11.3 上海华岭 芯片封测产品规格、参数及市场应用
  - 8.11.4 上海华岭 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）
  - 8.11.5 上海华岭企业最新动态
- 8.12 利扬芯片
  - 8.12.1 利扬芯片基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位
  - 8.12.2 利扬芯片公司简介及主要业务
  - 8.12.3 利扬芯片 芯片封测产品规格、参数及市场应用
  - 8.12.4 利扬芯片 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）
  - 8.12.5 利扬芯片企业最新动态
- 8.13 Applied Materials
  - 8.13.1 Applied Materials基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位
  - 8.13.2 Applied Materials公司简介及主要业务
  - 8.13.3 Applied Materials 芯片封测产品规格、参数及市场应用
  - 8.13.4 Applied Materials 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）
  - 8.13.5 Applied Materials企业最新动态
- 8.14 ASM Pacific Technology
  - 8.14.1 ASM Pacific Technology基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位
  - 8.14.2 ASM Pacific Technology公司简介及主要业务
  - 8.14.3 ASM Pacific Technology 芯片封测产品规格、参数及市场应用
  - 8.14.4 ASM Pacific Technology 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）
  - 8.14.5 ASM Pacific Technology企业最新动态
- 8.15 Kulicke & Soffa Industries
  - 8.15.1 Kulicke & Soffa Industries基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位
  - 8.15.2 ASM Pacific Technology公司简介及主要业务
  - 8.15.3 Kulicke & Soffa Industries 芯片封测产品规格、参数及市场应用
  - 8.15.4 Kulicke & Soffa Industries 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）
  - 8.15.5 Kulicke & Soffa Industries企业最新动态
- 8.16 TEL
  - 8.16.1 TEL基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

## 8.16.2 TEL公司简介及主要业务

### 8.16.3 TEL 芯片封测产品规格、参数及市场应用

### 8.16.4 TEL 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

### 8.16.5 TEL企业最新动态

## 8.17 Tokyo Seimitsu

### 8.17.1 Tokyo Seimitsu基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

### 8.17.2 Tokyo Seimitsu公司简介及主要业务

### 8.17.3 Tokyo Seimitsu 芯片封测产品规格、参数及市场应用

### 8.17.4 Tokyo Seimitsu 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

### 8.17.5 Tokyo Seimitsu企业最新动态

## 8.18 UTAC

### 8.18.1 UTAC基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

### 8.18.2 UTAC公司简介及主要业务

### 8.18.3 UTAC 芯片封测产品规格、参数及市场应用

### 8.18.4 UTAC 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

### 8.18.5 UTAC企业最新动态

## 8.19 Hana Micron

### 8.19.1 Hana Micron基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

### 8.19.2 Hana Micron公司简介及主要业务

### 8.19.3 Hana Micron 芯片封测产品规格、参数及市场应用

### 8.19.4 Hana Micron 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

### 8.19.5 Hana Micron企业最新动态

## 8.20 OSE

### 8.20.1 OSE基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

### 8.20.2 OSE公司简介及主要业务

### 8.20.3 OSE 芯片封测产品规格、参数及市场应用

### 8.20.4 OSE 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

### 8.20.5 OSE企业最新动态

## 8.21 NEPES

### 8.21.1 NEPES基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

### 8.21.2 NEPES公司简介及主要业务

### 8.21.3 NEPES 芯片封测产品规格、参数及市场应用

### 8.21.4 NEPES 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

### 8.21.5 NEPES企业最新动态

## 8.22 Unisem

8.22.1 Unisem基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

8.22.2 Unisem公司简介及主要业务

8.22.3 Unisem 芯片封测产品规格、参数及市场应用

8.22.4 Unisem 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

8.22.5 Unisem企业最新动态

8.23 Signetics

8.23.1 Signetics基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

8.23.2 Signetics公司简介及主要业务

8.23.3 Signetics 芯片封测产品规格、参数及市场应用

8.23.4 Signetics 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

8.23.5 Signetics企业最新动态

8.24 Carsem

8.24.1 Carsem基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

8.24.2 Carsem公司简介及主要业务

8.24.3 Carsem 芯片封测产品规格、参数及市场应用

8.24.4 Carsem 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

8.24.5 Carsem企业最新动态

8.25 Teradyne

8.25.1 Teradyne基本信息、芯片封测市场分布、总部及行业地位

8.25.2 Teradyne公司简介及主要业务

8.25.3 Teradyne 芯片封测产品规格、参数及市场应用

8.25.4 Teradyne 芯片封测收入及毛利率（2018-2023）

8.25.5 Teradyne企业最新动态

9 研究成果及结论

详细请访问：<https://www.gonyn.com/report/1552446.html>